



有機パッケージ・水晶デバイス用パッケージ の需要増に対応 京セラ鹿児島川内工場に新 工場棟を建設

京セラ株式会社

2022年04月20日

京セラ株式会社（社長：谷本 秀夫）は、有機パッケージや水晶デバイス用パッケージなど、半導体部品の増産に伴う生産スペース確保を目的に、鹿児島川内工場に国内最大の建屋となる第23工場を建設することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、本日、地元自治体である薩摩川内市と立地協定締結の調印式を行った後、2022年5月より新工場の建設を開始する予定です。

現在、有機パッケージは、5G（第5世代移動通信システム）の本格化により基地局やデータセンター向けの需要が拡大していることに加え、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転技術の高度化により、センサーカメラや高機能プロセッサ向けなどの需要の伸びが見込まれています。一方で、水晶デバイス用パッケージは、パソコンやスマートフォンといった情報端末から、家電、自動車、産業機械など、多様な機器に搭載されることから、今後も市場拡大が期待されています。

これらの需要増加に対応するため、2023年10月から新工場棟の稼働を順次開始し、有機パッケージの大幅な増産を進めるとともに、水晶デバイス用パッケージにおいても、市場動向等を踏まえながら、生産増強を図っていきます。なお、新工場棟の稼働により、同工場における有機パッケージの生産能力は、現状の約4.5倍となる見込みです。

京セラでは、旺盛な市場要求に対応することで、半導体部品事業の強化をはかるとともに、鹿児島県の経済活性化や新たな雇用機会創出による地域社会の発展に貢献してまいります。



完成予想図（第23工場）

■ 新工場の概要

名称 京セラ株式会社鹿児島川内工場 第23工場

所在地 鹿児島県薩摩川内市高城町2310-10

投資総額 約625億円

建築面積 12,380 m²（鉄骨、6階建）

延床面積 65,530 m²

建設計画 2022年5月着工、2023年10月操業

製品品目 有機パッケージ、水晶デバイス用パッケージなど

生産計画 約330億円／年（2024年4月～2025年3月）

※記載されている内容は、報道機関向けの発表文章であり、発表日現在のものです。ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。